

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成26年11月27日(2014.11.27)

【公開番号】特開2013-98332(P2013-98332A)

【公開日】平成25年5月20日(2013.5.20)

【年通号数】公開・登録公報2013-025

【出願番号】特願2011-239444(P2011-239444)

【国際特許分類】

H 01 L 23/50 (2006.01)

H 01 L 23/12 (2006.01)

H 01 L 25/04 (2014.01)

H 01 L 25/18 (2006.01)

【F I】

H 01 L 23/50 R

H 01 L 23/12 5 0 1 T

H 01 L 25/04 Z

H 01 L 23/50 X

【手続補正書】

【提出日】平成26年10月15日(2014.10.15)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0014】

図5(A)はリードフレーム10の表面、図5(B)はその裏面の平面構成をそれぞれ表すものである。図5のドットで表した領域は、図5(A)は表面から、図5(B)は裏面からそれぞれ一定の厚みだけ削られ、他の部分に比べて薄くなっている箇所を表している。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0015】

リードフレーム10は、例えばメッキされた銅(Cu)により構成され、チップ搭載領域11(ダイパッド)、端子12(信号端子)、リード領域13Aおよび端子12とリード領域13Aとの間の間隙14を有している。間隙14と端子12との間には端子12を支持する張出部15(図2)が設けられている。図5(A)のドット領域は張出部15、図5(B)のドット領域はリード領域13Aである。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0029

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0029】

続いて、封止樹脂41の表面に製品名等のマーク54を刻印した後(図12)、図13に表したようにカッター等により切断線55でリードフレームシートからリードフレーム

10を切り離す。以上の工程により、図1～4に示した半導体装置1が完成する。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0039

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0039】

半導体チップ21A, 21B, 21Cは互いの電極パッド同士がワイヤ31により電気的に接続され、リードフレーム10(チップ搭載領域11)に搭載されている。即ち、この半導体装置2は所謂マルチチップの構成を有するものである。

【手続補正5】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図13

【補正方法】変更

【補正の内容】

【図13】

